



## 中国工商银行股份有限公司

### 关于对外投资的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“基金”）出资人民币 215 亿元（以下简称“本次投资”）。

- 本次投资已经由本行董事会审议通过，无需提交本行股东大会审议。
- 本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

#### 一、本次投资概述

近日，本行与中华人民共和国财政部等 19 家机构签署《发起人协议》，拟向基金出资人民币 215 亿元，持股比例 6.25%，预计自基金注册成立之日起 10 年内实缴到位。

本次投资不属于本行重大资产重组事项，不构成本行的关联交易。

本次投资已经本行董事会于 2023 年 11 月 30 日审议通过。议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本行董事会审议通过上述议案时，本次投资尚未完成协议签署，基金尚未设立，存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《中国工商银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的有关规定，本行经审慎判断，决定暂缓披露本次投资，并按相关

规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

本次投资无需提交本行股东大会审议。

本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

## 二、投资标的基本情况

基金由中华人民共和国财政部等 19 家机构共同出资设立，注册资本为人民币 3,440 亿元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。基金旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全产业链。

## 三、本次投资对本行的影响

本次投资资金来源为本行自有资金。本次投资是本行结合国家对集成电路产业发展的重大决策、本行的发展战略及业务资源作出的重要布局，是本行服务实体经济、推动经济和社会可持续发展的战略选择，是本行践行大行担当的又一大举措，对于推动本行金融业务发展具有重要意义。

## 四、本次投资的风险分析

根据《发起人协议》约定，本行应自基金注册成立之日起 10 年内按照认购的股份全额缴纳股款，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（2024 年 7 月 1 日实施）等相关法律法规，上述出资期限安排尚需根据法律法规取得相关部门同意。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十七日